

無塵包装・帯電防止包装用乾燥剤

# TA・TST シリーズ

TA・TSTシリーズは、タイベック®(\*1)を用いた無塵包装用乾燥剤です。さらに帯電防止処理されているので、静電気障害を受けやすい電子部品・半導体などの防湿包装にも適しています。

## ■用途

- ・半導体・電子部品・コンピュータ部品
- ・医薬品・試薬・診断用キット など



### TA・TST の優れた特長

- ・包装材料としてデュポン社のタイベック®を用いており、粉やほこりが出ません。
- ・使用する乾燥剤はシリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。
- ・耐久性、耐水性および低リント性に優れています。
- ・用途に応じた2種類のパッケージデザイン。
- ・帯電防止効果により静電破壊対策にも優れています。

## ■吸湿性能

TA・TSTシリーズは、包装用JIS規格(\*2)をクリアしています。主成分のA型シリカゲルは、特に低湿度域での吸湿力に優れています。

物性		TA・TST	JIS規格
吸湿率	関係湿度20%	10.0以上	8.0以上
	関係湿度50%	25.0以上	20.0以上
	関係湿度90%	35.0以上	30.0以上
含水率(%)		2.5以下	2.5以下
pH		4~8	4~8

## ■安全性

主成分のA型シリカゲルは、食品添加物にも指定されている安全性の高い物質です。しかも、化学的にも安定しており、無味、無臭かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。また、高度の品質管理下で加工処理されますので、性能は一定しています。

代表的化学組成(乾量基準)

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CAO	NA <sub>2</sub> O
99.82%	0.01%	0.01未満	0.02%	0.03%

## ■包装材料

TA・TSTシリーズは、包装材料としてデュポン社のタイベック®を用いています。タイベック®は、引き裂き強度が強く、耐水性および低リント性に優れた高密度ポリエチレン繊維から作られたフィルムです。多孔性で中身の粉塵が漏れ出すことはありません。水蒸気透過性も高く、かつ、ほつれや毛羽立ちもありません。半導体、電子部品などの無塵包装、クリーンルームでの使用に適しています。また、帯電防止処理を施しているため、静電気障害を受けやすい電子部品の包装にも適しています。

発塵度(\*3)

	揉み	摩擦(10秒)	摩擦(180秒)
タイベック 1056D	0	0	5



## ■製品仕様

### ● TAシリーズ／乾燥剤小袋（3方シール）

コンパクトでスペースを取らず、一般の包装に適しています。



内容量	入り数(個)	製品寸法(mm)
5g	1,800	60×60
10g	1,000	60×80
20g	600	75×110
30g	400	75×110
50g	250	100×110

- 記載された製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 特注サイズなどの別注品については、別途ご相談ください。

### ● TSTシリーズ／乾燥剤小袋（スティックタイプ）

コンパクトで容器に直接投入し易く、非常に耐久性があって破れにくい。粉やほこりがでないデザインである。



内容量	入り数(個)	製品寸法(mm)
0.5g	12,000	20×30
1g	8,000	20×40
2g	4,000	23×55
3g	3,000	23×65

- 記載された製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 特注サイズなどの別注品については、別途ご相談ください。

\*1) タイベック®は米国デュポン社（E.I. du Pont de Nemours and Company）の登録商標です。

\*2) 包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格（JIS Z 0701）

\*3) 発塵度測定試験は、SEMI Doc No.2362に準じる。